471-5LL

PCB 及电子零件灌注胶

UL File No. E100866、E333984、E87039

特　　点

- 低稠度，作业时间长。低放热，低收缩，散热性良好。
- 收缩小，不会拉坏细线路及 Core，对电感（L 值）影响极小。

物　　性

		主剂(B 剂)		硬化剂(A 剂)
黏　　度	@25°C	12,500-25,000cps		20-50cps
比　　重	@25°C	1.67		0.96
闪　火　点	(ASTM D93)	＞94°C		＞90°C
重量混合比	(主剂：硬化剂)	100	:	15
体积混合比	(主剂：硬化剂)	100	:	25

混合后黏度	@25°C (ASTM D2196)	2,000-3,000 cps
可操作时间	@25°C	150 分钟
胶化时间	@25°C、150 克	6-10 小时
硬化条件	(基本硬化)	25°C x 24 小时 or 80°C x 4 小时
抗张强度	(ASTM D229)	5,700 psi (39.3 MPa)
断裂延伸率	(ASTM D229)	5 %
弯曲强度	(ASTM D790)	17,000 psi (117 MPa)
硬　　度		Shore D 80 (完全硬化)
玻璃转化温度(Tg)		50 °C
耐　燃　性	UL 94、2.9mm 厚	V–0
热膨胀系数	Tg 前	4 x 10^{-5} IN/IN/°C
	Tg 后	1.95 x 10^{-4} IN/IN/°C
热传导系数		0.5 W/mK (0.29 BTU/Hr/FT^2/FT/°F)
吸　水　率	@25°C、浸水 168 小时	0.4%
重量损失率	@135°C、浸水 168 小时	0.5%
绝　缘　强　度	(ASTM D149)、125mils	
	刚硬化后	510 Volts/mil (20 kV/mm)
	浸水 24 小时	480 Volts/mil (19 kV/mm)
绝　缘　常　数	@25°C、1KHz	4.2
消　散　因　素	@25°C、1KHz	0.03
体　积　电　阻	@25°C (ASTM D257)	1.5 x 10^{14} ohm-cm

※备注：样品放置25°C x 7天后可完全硬化。　※主剂(B剂)于使用前需搅拌均匀。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672　台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707　苏州：86-512-66106145

杰研贸易（上海）有限公司
www.jasdi.com.cn • jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975 • FAX：021-58356976